

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #2376

### 能呈EMC检验改进

2019-07-06 17:50 - 吴佳

状态:	新建	开始日期:	2019-07-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-07-09
指派给:	吴佳	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1: 采用的主机为4G主机 ( T200 ) . 2: 应对EMC检测应进行改进方法有 : A: 在机箱外壳内部增加黄铜网进行电磁屏蔽。机箱盖应戳开绝缘层使上下盖导通接触良好。 B: 增大RS232, RS485, DI电路的信号线输入阻抗。 C: 机箱内电源线, 信号排线使用铜丝网包裹并打胶固定。 D: 机箱内螺钉全部打胶固定。			

#### 历史记录

#1 - 2019-07-10 09:13 - 吴佳

20190709完成 1扩展板原飞线部分电路改进, 并发板制样5片。 2壳体上下部分连接处已经戳开绝缘层, 确保连接良好。  
3已经对RS485电路进行改进, 前端磁珠位置改焊自恢复保险。RS232电路前端电阻由200R/0805改为1K/0805  
等待带屏蔽导线及120目铜丝网到货对连接及箱体进行改进

#2 - 2019-07-15 20:27 - 吴佳

- % 完成 从 0 变更为 80

经辛桂明确认, 能呈认为我方报价过高而停止对4G主机EMC测试的要求。 但由于我已经实施了改进的措施包括重新制作扩展板, 因此我将按计划改进完成一套4G主机待用。

#3 - 2019-07-18 13:31 - 吴佳

20190717完成装配

#4 - 2019-07-18 13:32 - 吴佳

- % 完成 从 80 变更为 100